

GAP PAD TGP 1500

GAP PAD TGP 1500

Thermally Conductive, Un-Reinforced, Silicone Based Pad



- Lämmönjohtavuus: 1.5 W/m-K
- Ilman vahvistetta oleva rakenne lisääntyneen taipuisuuden saavuttamiseksi
- Taipuisa, matala kovuus
- Sähköisesti eristävä



TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® GAP PAD TGP 1500:lla on ihanteellinen täyteaineyhdistelmä, mikä antaa sille matalan moduulin ominaisuuden ja ylläpitää optimaalista lämmönsiirtoa. Ainetta on helppo käsitellä.

Materiaalin molemmilla puolilla oleva luonnollinen tarttuvuus mahdollistaa hyvän mukautuvuuden komponenttien vierekkäisiin pintoihin, mikä minimoi rajapinnan vastuksen.